

Sample

English to German: Microsystems for real time IEQ control (excerpt)

Source text – English

Referring to Fig. 2, the current state of the art of microsystems is sufficient to create a microsystem operable to measure and/ or monitor IEQ parameters such as total volatile organic compounds (TVOC), temperature, mean radian temperature, air flow rate, CO, CO₂, relative humidity, light level, and even sound.

Each microsystem 12 may therefore employ MEMS sensors 20 that measure some or all of these values. The microsystem 12 may also incorporate processing circuitry 22, as well as radio frequency transmission circuitry 24. General examples of MEMS devices having processing circuitry and RF capability are discussed in U.S. Patent Application serial no 10/353,142 entitled "Building System with Reduced Wiring Requirements and Apparatus for Use Therein", filed January 28, 2003, and US Patent Application Serial No 10/672,527, filed September 26, 2003, entitled "Building Control System Using Integrated MEMS Device". Other devices of this nature are known.

In one embodiment, the processing circuitry 22 is programmed or otherwise configured to generate an IEQ index based on the various information obtained by the MEMS sensors 20, and cause the RF circuit 24 to communicate that index wirelessly to the network device 16. In other embodiments, the processing circuitry 22 merely obtains the sensor values and provides those values (preferably with some low pass filtering) to the RF circuit 24 for transmission to the network device 16. The RF circuit 24 may suitably use Bluetooth or other short range RF transmission technology. The microsystem 12 may further include a battery, not shown, to power the operations.

Translation – German

Es wird nun auf Figur 2 Bezug genommen. Nach dem derzeitigen Stand der Technik bei Mikrosystemen lässt sich bereits ein Mikrosystem herstellen, das IUQ-Parameter wie den Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (GFOV), die Temperatur, die mittlere Strahlungstemperatur, den Luftvolumenstrom, CO, CO₂, relative Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke und sogar Geräusche messen und/ oder überwachen kann.

Jedes Mikrosystem 12 kann demnach MEMS-Sensoren 20 einsetzen, die einige dieser Werte oder alle messen. Das Mikrosystem 12 kann auch Verarbeitungsschaltungen 22 sowie Hochfrequenzübertragungsschaltungen 24 enthalten. Allgemeine Beispiele für MEMS-Bauelemente mit Verarbeitungsschaltungen und HF-Funktionalität werden in der US-Patentanmeldung mit der Seriennummer 10/353,142 und dem Titel „Building System with Reduced Wiring Requirements and Apparatus for Use Therein“ (eingereicht am 28. Januar 2003) und in der US-Patentanmeldung mit der

Seriennummer 10/672,527 und dem Titel „Building Control System Using Integrated MEMS Device“ (eingereicht am 26. September 2003) erläutert. Es sind andere Einrichtungen dieser Art bekannt.

Bei einer Ausführungsform sind die Verarbeitungsschaltungen 22 so programmiert oder anderweitig konfiguriert, dass sie auf der Grundlage der verschiedenen von den MEMS-Sensoren 20 abgefragten Informationen einen IUQ-Index erzeugen und die HF-Schaltung 24 dazu veranlassen, diesen Index auf drahtlosem Wege an die Netzwerkeinrichtung 16 zu übermitteln. Bei anderen Ausführungsformen fragen die Verarbeitungsschaltungen 22 lediglich die Sensorwerte ab und stellen diese Werte (vorzugsweise in gewissem Ausmaß tiefpassgefiltert) der HF-Schaltung 24 zum Übertragen an die Netzwerkeinrichtung 16 zur Verfügung. Die HF-Schaltung 24 kann entsprechend Bluetooth- oder andere HF-Übertragungstechnik mit geringer Reichweite verwenden. Das Mikrosystem 12 kann ferner eine (nicht gezeigte) Batterie für die Betriebsstromversorgung aufweisen.

English to German: Housing for electrical components (claims)

Source text – English

1. A housing (10) for electrical components, the housing having a mouth portion (14) to cooperate with a circuit board (12) in an assembled condition wherein said circuit board (12) is applied against said mouth portion (12) of the housing (10), the housing (10) characterised in that it includes:
 - at least one spring formation (201) located at said mouth portion (14) to cooperate with said circuit board (12) to elastically urge said circuit board (12) away from said mouth portion (14), and
 - at least one hook-like formation (202) extending from said mouth portion (14) distally of said housing (10), said hook-like formation (202) adapted to cooperate with said circuit board (12) to retain said circuit board (12) assembled to said housing (10) against the force exerted by said spring formation (201).
2. The housing of claim 1, including a plurality of locking assemblies (20), each assembly including one said spring formation (201) and one said hook-like formation (202), said locking assemblies distributed over the periphery of said mouth portion (14).
3. The housing of either of claims 1 or 2, wherein said at least one spring formation (201) and said at least one hook-like formation (202) are integrally formed with said housing (10).
4. The housing of any of the previous claims, wherein said at least one spring formation (201) is in the form of a flexible cantilever beam.
5. The housing of any of the previous claims, wherein said at least one spring formation (201) is an L-shaped formation.
6. The housing of any of the previous claims, wherein said at least one spring formation (201) includes a distal head (2012) to cooperate with said circuit board (12).

7. The housing of any of the previous claims, for assembly with the circuit board (102) having a given thickness, said circuit board (12) coupled with a further element (18) having a web portion having a respective thickness, wherein said at least one hook-like formation has a length corresponding to the combined thickness of said circuit board (12) and said web portion (18) of said further element (18).
8. The housing of any of the previous claims, wherein said at least one hook-like formation (202) includes a distal hook portion projecting radially inwardly of the housing (10).
9. The housing of any of the previous claims, including at least one further hook-like formation (203) located at said mouth portion (14) and having a distal hook formation projecting radially outwardly of said housing (10).
10. The housing of claim 9, including a flange defining said mouth portion (14) of the housing (10), said flange provided with openings (16) bestowing on said flange a grid-like structure forming passageways for cooling air and wherein said further hook-like formation (203) has a channel-like structure defining a flow path for said cooling air.
11. The housing of either of claims 9 or 10, wherein said further hook-like formation (203) is integrally formed with said housing (11).
12. The housing of any of the previous claims wherein said housing includes thickened portions (22) having openings (24) for fixing screws extending therethrough.

Translation – German

1. Gehäuse (10) für elektrische Komponenten, das einen Öffnungsabschnitt (14) aufweist, der im zusammengebauten Zustand mit einer Leiterplatte (12) zusammenwirkt, wobei die Leiterplatte (12) an den Öffnungsabschnitt (14) des Gehäuses (10) angelegt ist, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es Folgendes aufweist:
 - mindestens eine Federstruktur (201), die sich an dem Öffnungsabschnitt (14) befindet und mit der Leiterplatte (12) so zusammenwirkt, dass die Leiterplatte (12) elastisch von dem Öffnungsabschnitt (14) weg gedrückt wird, und
 - mindestens eine hakenartige Struktur (202), die sich ausgehend von dem Öffnungsabschnitt (14) distal vom Gehäuse (10) weg erstreckt, wobei die hakenartige Struktur (202) so ausgelegt ist, dass sie mit der Leiterplatte (12) zusammenwirkt, so dass diese entgegen der von der Federstruktur (201) ausgeübten Kraft am Gehäuse (10) montiert bleibt.
2. Gehäuse nach Anspruch 1 mit mehreren Verriegelungsbaugruppen (20), wobei jede Baugruppe eine solche Federstruktur (201) und eine solche hakenartige Struktur (202) aufweist und die Verriegelungsbaugruppen über den Umfang des Öffnungsabschnitts (14) verteilt sind.
3. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die mindestens eine Federstruktur (201) und die mindestens eine hakenartige Struktur (202) in das Gehäuse (10) eingeformt sind.
4. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die mindestens eine Federstruktur (201) in Form eines einseitig eingespannten Biegebalkens vorliegt.

5. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die mindestens eine Federstruktur (201) als L-förmige Struktur vorliegt.
6. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die mindestens eine Federstruktur (201) einen distalen Kopf (2012) aufweist, der mit der Leiterplatte (12) zusammenwirkt.
7. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Montieren an die Leiterplatte (12) mit einer gegebenen Dicke, wobei die Leiterplatte (12) mit einem weiteren Element (18) mit einem Stegabschnitt mit einer jeweiligen Dicke gekoppelt ist, wobei die mindestens eine hakenartige Struktur eine Länge aufweist, die der kombinierten Dicke von Leiterplatte (12) und Stegabschnitt (18) des weiteren Elements (18) entspricht.
8. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die mindestens eine hakenartige Struktur (202) einen distalen Hakenabschnitt aufweist, der radial in das Gehäuse (10) hineinragt.
9. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit mindestens einer weiteren hakenartigen Struktur (203), die sich am Öffnungsabschnitt (14) befindet und eine distale Hakenstruktur aufweist, die radial aus dem Gehäuse (10) herausragt.
10. Gehäuse nach Anspruch 9 mit einem Flansch, der den Öffnungsabschnitt (14) des Gehäuses (10) definiert, wobei der Flansch mit Löchern (16) versehen ist, die dem Flansch einen gitterartigen Aufbau verleihen, der Durchgänge für Kühlluft bildet, und wobei die weitere hakenartige Struktur (203) einen kanalartigen Aufbau aufweist, der einen Strömungsweg für die Kühlluft definiert.
11. Gehäuse nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die weitere hakenartige Struktur (203) in das Gehäuse (11) eingeformt ist.
12. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse verdickte Abschnitte (22) mit Löchern (24) zum Befestigen von dadurch verlaufenden Schrauben aufweist.

English to German: Fill valve (1st claim)

Source text – English

1. A reservoir structure (10) of a fuel delivery structure for a diesel vehicle, the reservoir structure (10) including:
 - a fuel reservoir (11) having a bottom surface (14),
 - a primary fill opening (12) in the bottom surface (14) for permitting fuel to pass from a fuel tank (33) of the vehicle into the reservoir (11),
 - a secondary fill opening (16) in the reservoir (11) that is elevated from the bottom surface (14),
 - a first valve member (13) associated with the primary fill opening (12) constructed and arranged to close the primary fill opening (12) under certain pressure conditions in the reservoir (11) and, under pressure conditions in the reservoir (11) different from the certain pressure conditions, to permit fuel to enter the reservoir (11) through the primary fill opening (12), and

a second valve member (18) associated with the secondary fill opening (16) constructed and arranged to close the secondary fill opening (18) under certain pressure conditions in the reservoir (10) and, under pressure conditions in the reservoir (11) different from the certain pressure conditions, to permit fuel to enter the reservoir (11) through the secondary fill opening (18) in the event the primary opening (12) is substantially blocked.

Translation – German

1. Vorratsbehälterkonstruktion (10) einer Kraftstoffzufuhrkonstruktion für ein Dieselfahrzeug, wobei die Vorratsbehälterkonstruktion (10) Folgendes aufweist:

einen Kraftstoffvorratsbehälter (11) mit einer Bodenfläche (14),

eine Primärfüllöffnung (12) in der Bodenfläche (14), damit Kraftstoff von einem Kraftstofftank (33) des Fahrzeugs in den Vorratsbehälter (11) strömen kann,

eine Sekundärfüllöffnung (16) in dem Vorratsbehälter (11), die zur Bodenfläche (14) erhöht liegt,

ein erstes Ventilelement (13), das zur Primärfüllöffnung (12) gehört und so konstruiert und angeordnet ist, dass es unter bestimmten Druckverhältnissen im Vorratsbehälter (11) die Primärfüllöffnung (12) schließt und unter Druckverhältnissen im Vorratsbehälter (11), die sich von diesen bestimmten Druckverhältnissen unterscheiden, Kraftstoff durch die Primärfüllöffnung (12) in den Vorratsbehälter (11) strömen lässt, und

ein zweites Ventilelement (18), das zur Sekundärfüllöffnung (16) gehört und so konstruiert und angeordnet ist, dass es unter bestimmten Druckverhältnissen im Vorratsbehälter (11) die Sekundärfüllöffnung (16) schließt und unter Druckverhältnissen im Vorratsbehälter (11), die sich von diesen bestimmten Druckverhältnissen unterscheiden, Kraftstoff durch die Sekundärfüllöffnung (16) in den Vorratsbehälter (11) strömen lässt, wenn die Primärfüllöffnung (12) im Wesentlichen blockiert ist.

English to German: Patent claim

Source text – English

A reception method wherein signals supplied from a radio path are received, characterized by

determining a propagation delay profile of the channel,

determining the strengths of multipath propagated signal components within the propagation delay profile,

forming sums of the strength of the multipath propagated signal components,

selecting from among the multipath propagated signal components those whose delay values deviate at least by a predetermined delay difference and whose sum of the strengths obtains the highest possible value, indicating information by using said multipath propagated signal components.

Translation – German

Empfangsverfahren, wobei Signale empfangen werden, die über einen Funkweg bereitgestellt werden, gekennzeichnet durch

Bestimmen eines Ausbreitungsverzögerungsprofils des Kanals,

Bestimmen der Stärken von Mehrwegausbreitungssignalkomponenten mit einem Ausbreitungsverzögerungsprofil,

Bilden von Summen der Stärken der Mehrwegausbreitungssignalkomponenten,

Auswählen aus den Mehrwegausbreitungssignalkomponenten diejenigen, deren Verzögerungswerte um wenigstens eine vorbestimmte Verzögerungsdifferenz abweichen, und deren Summenstärken den höchstmöglichen Wert erzielen,

Anzeigen von Information durch Benutzen der ausgewählten Mehrwegausbreitungssignalkomponenten.

English to German: Patent claim

Source text – English

An electronic driver circuit for generating a circuit output signal providable to an electrical conductor (12) that furnishes a conductor output signal providable to a load (14), the circuit and conductor output signals respectively making corresponding circuit and conductor output transitions approximately between a pair of output voltage levels (VDD, VSS) between which there is an intermediate voltage level (VHH), inductance and capacitance of the conductor and the load producing resonance that enables the conductor output signal to largely complete each conductor output transition while the circuit output signal is being held at approximately the intermediate voltage level for a non-zero intermediate-level holding period during the corresponding circuit output transition, the circuit comprising a ramp control circuit (118, 119) for controlling partial circuit output transitions between at least one of the pair of output voltage levels and the intermediate level to provide a substantially non-zero transition for a partial circuit output transition.

Translation – German

Elektronische Treiberschaltung zum Erzeugen eines Schaltungsausgangssignals, das an einen elektrischen Leiter (12) bereitstellbar ist, der ein Leiterausgangssignal liefert, das an eine Last (14) bereitstellbar ist, wobei das Ausgangssignal der Schaltung und des Leiters jeweils annähernd zwischen einem Paar von Ausgangsspannungspegeln (VDD, VSS), zwischen denen ein mittlerer Spannungspegel (VHH) vorliegt, einen entsprechenden Ausgangsübergang vollziehen, wobei die Induktivität und die Kapazität des Leiters und die Last eine Resonanz erzeugen, die es ermöglicht, dass das Leiterausgangssignal jeden Leiterausgangsübergang im Wesentlichen abschließt, während das Schaltungsausgangssignal für eine Nichtnull-Mittelpegelhalteperiode annähernd auf dem mittleren Spannungspegel gehalten wird, wobei die Schaltung eine Rampensteuerungsschaltung (118, 119) zum Steuern von partiellen Schaltungsausgangsübergängen zwischen wenigstens einem Pegel des Paares von Ausgangsspannungspegeln und dem mittleren Pegel umfasst, um für einen partiellen Schaltungsausgangsübergang eine Übergangszeit bereitzustellen, die im Wesentlichen nicht Null ist.